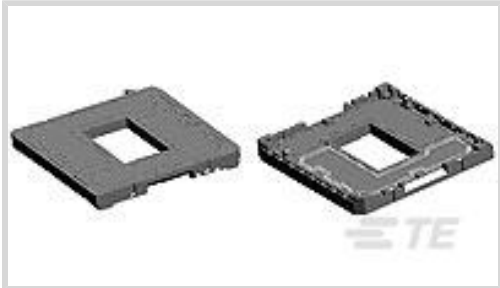




连接器 > 接口插槽 > IC 插座 > LGA 插座



IC 插座类型: LGA 1155

位数: 1155

PCB 端接方法: 表面贴装 - 焊球

栅格间距: .914 x .914 mm [.036 x .036 in]

产品特性

结构特性

位数	1155
栅格间距	.914 x .914 mm[.036 x .036 in]

主体特性

框架种类	正方形，小型
------	--------

接触件特性

端子接触部电镀材料	镀金
端子基材	铜合金
IC 插座类型	LGA 1155

端接特性

PCB 端接方法	表面贴装 - 焊球
----------	-----------

壳体特性

外壳材料	高温热塑塑料
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

托盘颜色	黑色
封装方法	Box

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

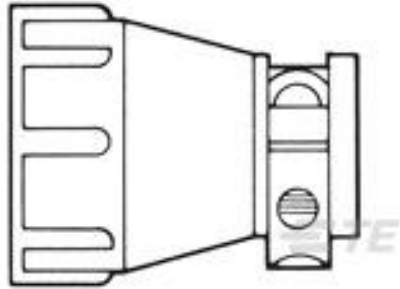


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2018年6月（191） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号206138-8
CLAMP CBL SHELL SIZE 23



TE 产品编号1-66098-8
III+ PIN,18-16,TIN STRIP



TE 产品编号1734753-1
MINI USB, TYPE B, VERTICAL, T/H



TE 产品编号3-66104-0
III+ SKT,24-20,TIN ,STRIP



TE 产品编号5406299-1
MJ ASSY,S/P,8POS,SH,RVPGT,CAT 5e



TE 产品编号3-1649329-1
RT444012



TE 产品编号206036-1
RECEPT,SZ 17-16 CPC



TE 产品编号2-66102-5
III+ PIN,24-20,TIN ,STRIP



TE 产品编号206838-1
23-24 RECEPT



TE 产品编号2331414-1
DET SW4.2X3.6X1.2 GW VERT(DW)
NO AGAU RL

文档

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_2069965-3_E.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2069965-3_E.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2069965-3_E.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。